

## 技術詞彙表

本技術詞彙表載有本文件所採用有關我們業務的詞彙。因此，該等詞彙及其定義未必與業內標準定義或該等詞彙的用途相符。

「2D集成」	指	將所有芯片及被動元件水平安裝於基板表面的集成方式
「2.5D集成」	指	一種介於傳統2D集成與更先進3D集成之間的半導體封裝技術
「3D集成」	指	通過垂直堆疊不同芯片或晶圓形成單一封裝的三維集成電路
「每個接觸點4A」	指	單個接觸點在正常操作條件下可穩定傳輸最大4安培電流
「5G」	指	第五代移動通信技術，具備高數據傳輸速率、低延時及大連接特性
「AI」	指	人工智能
「互補金屬氧化物半導體圖像傳感器」	指	互補金屬氧化物半導體圖像傳感器，一種將光學信號轉換為電子信號以捕捉數字圖像或視頻的半導體器件
「同軸探針」	指	專為高頻信號完整性設計的探針，採用同軸結構(受屏蔽的中心導體)以提供受控阻抗。其主要功能為通過防止訊號劣化及外部干擾，對射頻或高速數字信號的精確、低噪聲測量。
「同軸座」	指	專為高速傳輸及高頻測試設計的精密產品，可同時支持工程測試與量產
「接觸力」	指	半導體測試過程中探針與芯片焊盤或引腳接觸時施加的力
「CP探針」	指	芯片探測探針，於芯片探測過程中使用的精密探針，通過接觸晶圓上的晶粒實現電氣連接以進行功能與性能測試
「dB」	指	分貝，聲音強度的對數單位

## 技術詞彙表

「深拉深沖壓」	指	使用沖壓設備將金屬板材拉伸成具有大深度的複雜3D結構的精密金屬成型工藝
「晶粒」	指	晶圓切割後獲得的單個芯片單元，為半導體器件的基本功能單元，包含完整電路結構
「EMI屏蔽罩」	指	電磁干擾屏蔽罩用於阻隔電磁干擾的金屬屏蔽裝置，可降低電子設備內部組件間的電磁干擾並提升信號傳輸穩定性
「ERP軟件」	指	企業資源規劃軟件，整合企業內部資源管理的信息系統
「細間距」	指	描述半導體芯片引腳或焊盤間微小間距的特徵
「FT」	指	最終測試，半導體製造中的後端測試流程，於芯片完成封裝後進行，測試芯片的最終功能與可靠性以確保產品符合交付標準
「FT探針」	指	最終測試探針，用於半導體製造最終測試階段的專用電氣連接器，其主要功能為在封裝裝置的引腳或焊盤與測試設備之間建立臨時且可靠的電氣連接，藉此在裝置出貨予客戶之前驗證其完整功能、性能及電氣特性。
「齒輪箱」	指	機械傳動系統的核心組件，通過齒輪組配置實現速度與扭矩轉換
「齒輪系」	指	由多個嚙合齒輪組成的傳動系統，用於傳遞動力、改變運動方向或調節速度
「建築面積」	指	建築面積
「GHz」	指	千兆赫，每秒1,000,000,000個週期
「GPU」	指	圖形處理單元
「HDI」	指	高密度互聯，實現集成電路基板高密度佈線的技術

---

## 技術詞彙表

---

「IATF」	指	國際汽車工作組，由主要汽車製造商及協會組成的組織，負責制定及維護汽車行業品質管理標準IATF 16949，該標準以ISO 9001為基礎，並增加針對汽車行業的特定要求
「IC」	指	集成電路，將晶體管、電阻器及電容器等多個互連電子元件製造於單一芯片上的緊湊型半導體器件
「IC基板」	指	集成電路基板，承載芯片並實現芯片與外部電路電氣連接的關鍵組件
「阻抗」	指	電路中對交流電的總阻力，由電阻、電感及電容決定，是衡量電路信號傳輸特性的重要參數
「插入損耗」	指	信號通過連接器、電纜或其他組件時的功率衰減，通常以dB表示
「IoT」	指	物聯網
「IP67」	指	侵入防護等級之一，第一位數字「6」表示完全防塵，並防止大於1毫米的物體侵入；而第二位數字「7」表示防止裝置在最多1公尺深的水中短時間浸沒時受到損害
「ISO」	指	國際標準化組織，由評估商業組織品質系統的非政府組織環球國際驗證股份有限公司發佈的一系列國際標準，包括品質管理及品質保證標準
「MEMS」	指	微機電系統，整合微機械結構、微感測器、微執行器及訊號處理電路的微系統
「MEMS聲學元件」	指	採用半導體製造技術製成的微型電子元件。術語「聲學」指其功能：將機械聲波或振動波轉換為電信號，或將電信號轉回聲波或振動。

## 技術詞彙表

「MEMS微納米製造元件」	指	採用微納米製造技術生產的MEMS裝置配套元件，包括結構件及連接器，用於支持MEMS裝置的功能實現
「微納米製造」	指	用於製造特徵尺寸從1納米到1,000微米的微結構及元件的技術的總稱，涵蓋各種精密加工工藝
「微注射成型」	指	一種將材料注入微模具以形成小而複雜的三維結構的精密製造工藝
「微精密沖壓」	指	一種高精度金屬成型工藝，利用精密模具及設備將金屬板材加工成小而複雜的結構件，確保高尺寸精度及一致性
「微型傳動系統」	指	用於小型設備的動力傳輸及運動控制系統，通常包括齒輪及馬達等部件，具有體積小、精度高的特點
「OEM」	指	原始設備製造商，為品牌商提供定製化產品製造服務的製造商，按照客戶的設計要求生產產品
「焊盤」	指	半導體芯片表面用於電氣連接的金屬區域，作為芯片與外部電路進行訊號傳輸的介面
「PCB」	指	印刷電路板，一種用於組裝電子元件並將其連接成統一電路的結構，允許電流在元件之間流通
「銷釘」	指	一種細長的部件，通常為圓柱形或桿狀，由金屬或陶瓷等材料製成，主要用於電氣連接、機械定位或緊固或小型機構的結構支撐
「平整度」	指	表面或結構的平整程度，沒有明顯的翹曲、彎曲或不規則
「精密金屬成型」	指	透過沖壓、拉伸等工藝將金屬材料加工成高精度、複雜結構件的技術總稱
「精密結構件」	指	尺寸精度高、幾何形狀複雜的結構件

## 技術詞彙表

「探針卡」	指	電子測試系統及半導體晶圓之間的介面，通常與測試機進行機械對接，並與測試儀進行電氣連接
「QFN」	指	四方扁平無引腳封裝，一種半導體芯片封裝形式，其特點是沒有外部引腳且封裝尺寸小
「研發」	指	研究與開發
「半導體測試探針」	指	用於半導體測試的精確探針，實現芯片測試過程中的電氣連接，傳輸測試訊號，並確保測試精度
「SNR」	指	訊噪比，有用訊號強度與背景雜訊強度的比率
「SoC」	指	系統單芯片，一種在單一芯片上整合處理器、記憶體及介面等多個功能模組以實現完整系統功能的半導體裝置
「插座」	指	一種精密介面元件，用於固定、定位另一個零件並與其建立電氣接觸
「SOP」	指	標準作業程序
「平方米」	指	平方米
「襯底」	指	建構集成電路等半導體裝置的基礎材料，作為沉積及整合構成電子電路基礎的各種半導體材料及組件的平台
「公差」	指	產品關鍵尺寸、形狀或性能參數在製造過程中的允許變動範圍
「晶圓」	指	電子領域用於製造集成電路的半導體物質薄片(如晶矽)
「VMI寄售」	指	供應商管理存貨寄售，一種供應鏈管理策略，由供應商管理客戶所在地的存貨，惟存貨仍歸供應商所有並由其維護